Teknologi pengemasan untuk rangkaian terpadu VLSI

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20288495&lokasi=lokal>

Abstrak

Dalam perkembangannya, teknologi semikonduktor telah memmjukan kecendemngan ke arah bentuk fisik yang semakin kecil, kecepatan proses yang semakin tinggi, jumlah transistor yang kandung semakin banyak, kehandalan yang semakin baik, dan harga yang semakin murah. Tapi segala kecenderungan yang bersifat meningkatkan mutu rangkaian terpadu ini memiliki segi lain yang merupakan kompensasinya yang bersifat merugikan, seperti flux panas yang terjadi. Untuk mengatasi hal itu, salah satunya, adalah dengan teknologi perakitan dan pengemasan yang baik. Sampai saat ini sudah ada beberapa teknologi yang umum digunakan untuk perakitan dan pengemasan rangkaian terpadu (IC). Tapi sesuai dengan adanya IC yang memiliki unjuk kerja yang tinggi atau High Performance IC, maka teknologi pengemasan dituntut untuk dapat mengatasi masalah-masalah yang timbul sebagai akibat karakteristik-karakteristik High Performance IC tersebut.